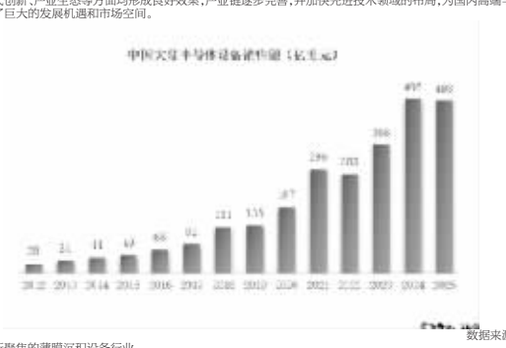
（上接B689版）

数据来源：SEMI

中国大陆作为全球最大的半导体芯片的需求市场，也为半导体设备带来了广阔的市场空间，随着人工智能（AI）高速发展对先进芯片的需求巨增，中国大陆对先进半导体设备的需求呈现持续增长的态势。根据SEMI最新统计，2025年中国大陆半导体设备销售额近到约433亿美元，较2024年基本持平，占当年全球半导体制造设备销售额约36.51%，自2020年起连续稳居全球半导体设备最大市场。

近年来，在复杂多变的国际形势及我国持续加大半导体产业政策扶持的背景下，中国大陆半导体产业发展迅速，在半导体技术迭代创新，产业生态等方面均形成良好效果，产业链逐步完善，并加快先进技术领域的布局，为国内高端半导体设备厂商创造了巨大的发展机遇和市场空间。



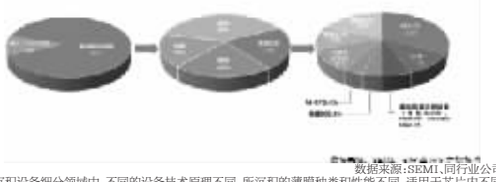
数据来源：SEMI

①公司所聚焦的薄膜沉积设备行业

在半导体设备产业中，薄膜沉积设备是前道芯片制造的三大核心装备之一，是实现集成电路先进逻辑及3D NAND、3D DRAM、高带宽存储器（HBM）等先进存储芯片技术突破的核心支撑。薄膜沉积设备所沉积的薄膜是芯片结构中的功能材料层，在芯片制造过程中需求量巨大，且直接影响芯片的性能。随着人工智能技术的快速发展，直接拉动先进逻辑芯片、先进存储及高带宽存储架构的市场需求，全球晶圆制造产能不断扩展、技术持续升级，这进一步显著拉动高端薄膜沉积设备的市场需求。

根据SEMI统计，2025年全球半导体芯片制造设备销售额增长11%，达到约1,157亿美元，占全球半导体设备销售额的比例约86%。而根据历史年度统计，薄膜沉积设备市场规模约占芯片制造设备市场的22%，由此推算，2025年全球薄膜沉积设备市场规模约为256亿美元。结合2024年中国大陆半导体制造设备销售额占全球半导体制造设备销售额的比例36.51%测算，2025年中国大陆薄膜沉积设备市场规模约93亿美元，具有广阔的市场空间。

根据SEMI历史统计，PECVD是薄膜设备中占比最高的设备类型，约占整体薄膜沉积设备市场的33%，ALD设备占比约为11%，而SACVD、HDPCVD、Flowable CVD属于其他薄膜沉积设备类目下的产品，占比约为6%。



数据来源：SEMI、同行业公司定期报告

在薄膜沉积设备细分领域中，不同的设备技术原理不同，所沉积的薄膜种类和性能不同，适用于芯片内不同的应用工序，其中公司所聚焦的PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD及Flowable CVD设备均属于CVD（化学气相沉积）细分领域产品，其主要应用及薄膜材料如图示：

PECVD SiN、SiO、TEOS、HDPCVD SiO
PECVD TEOS、FSG、Low-k
PECVD SiN、ADCI
PECVD ACHM、HDL、TWSI、ALD SiO
PECVD SiON、SiOC、TEOS、SiO
SiCN、a-Si、SiN
ALD SiO、SiN、TiO
PECVD SiON、SiOC、TEOS、SiO
ALD SiO、SiN、TiO
ALD SiO、SiN、W、HDPCVD SiO
Flowable CVD SiO、HDPCVD SiO
PECVD SiN、SiO、TEOS、HDPCVD SiO
PECVD TEOS、FSG、Low-k
PECVD SiN、ADCI
PECVD ACHM、HDL、TWSI、ALD SiO
PECVD SiON、SiOC、TEOS、SiO
SiCN、a-Si、SiN